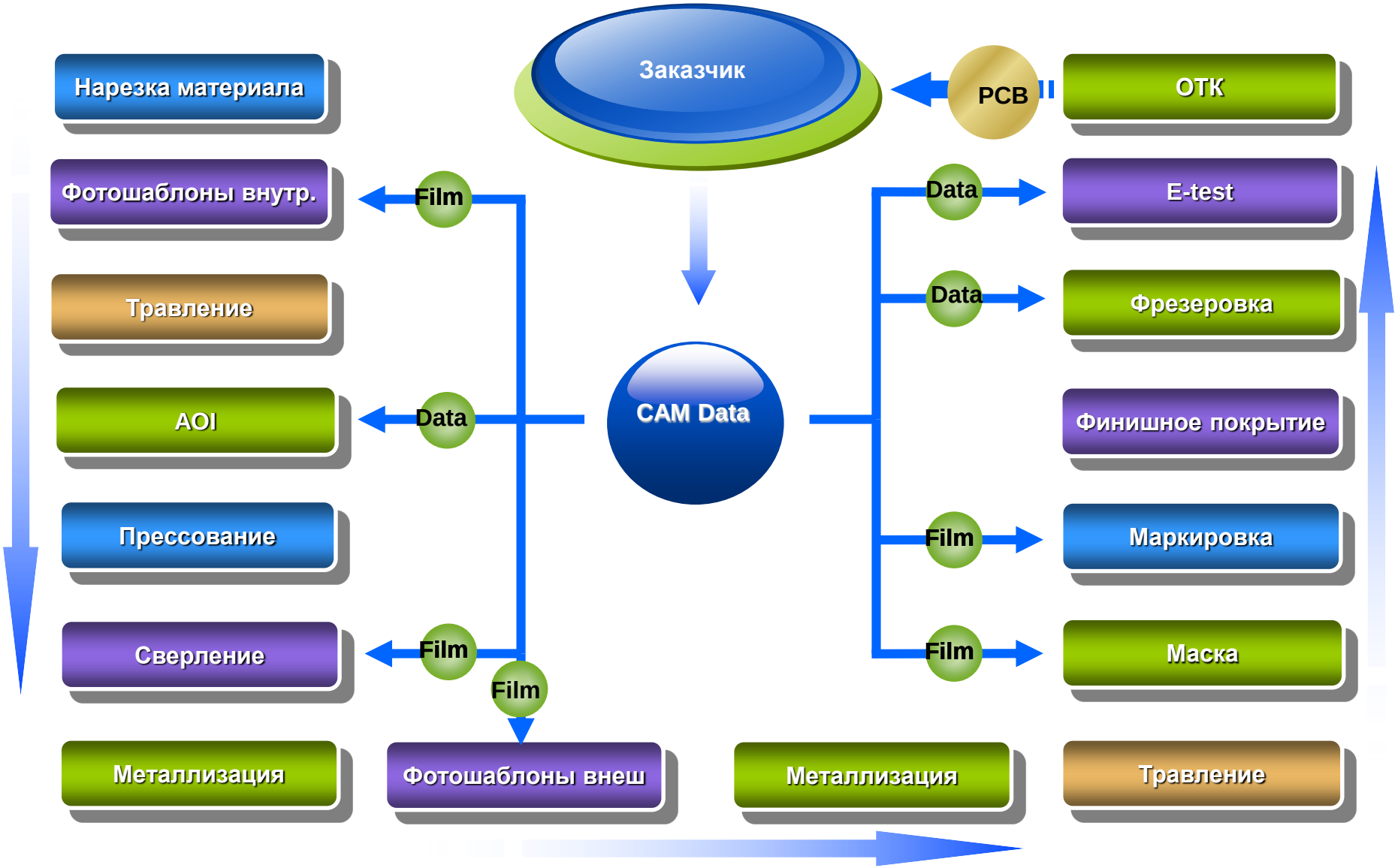
PCBtechnology

Процесс изготовления печатных плат

Семинар компании PCB technology Ltd.

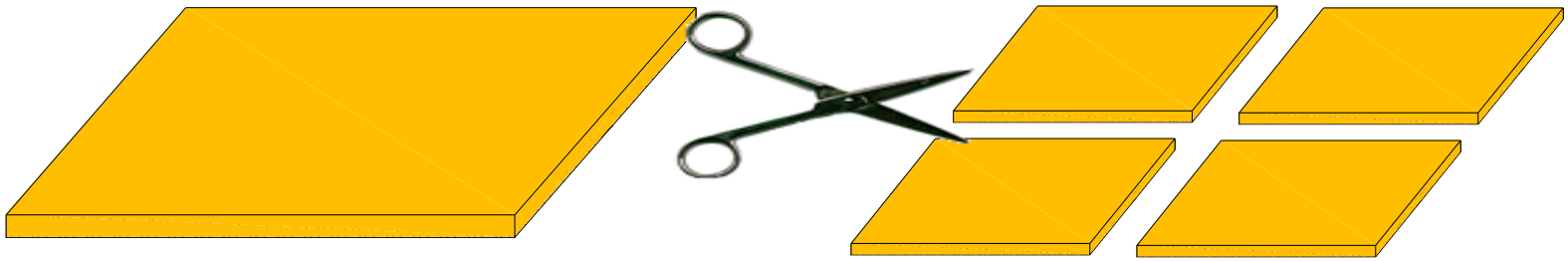
www.pcbtech.ru pcb@pcbtech.ru

Процесс изготовления ПП



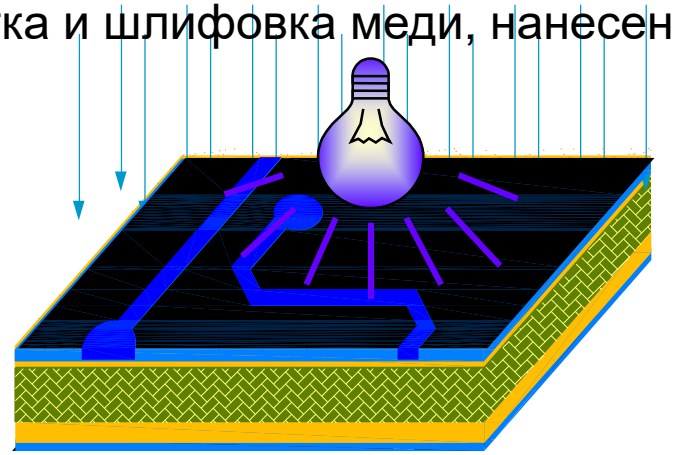
Нарезка

Разрезка листового материала на рабочие панели



Фотошаблоны внутр.слоев

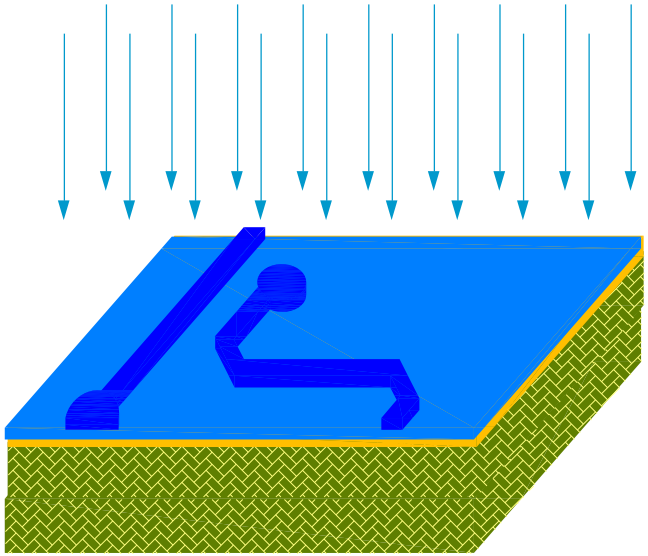
Шаг 1: Очистка и шлифовка меди, нанесение фоторезиста.



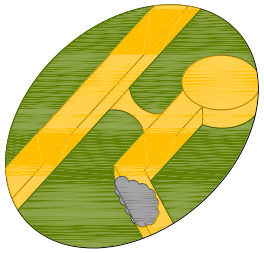
Шаг 2: Экспонирование и получение корректного рисунка проводников в слое фоторезиста.

Травление

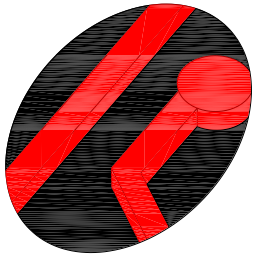
Проявление пленки фоторезиста, травление меди, не защищенной фоторезистом.



Инспекция AOI

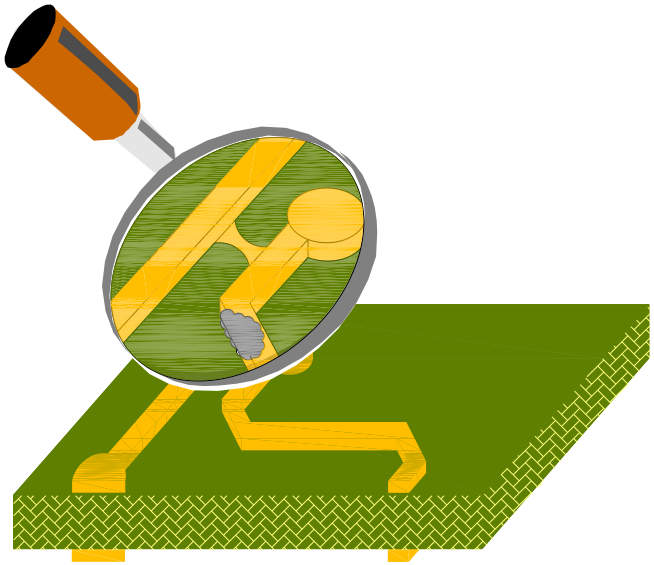


VS



Сканированный рисунок

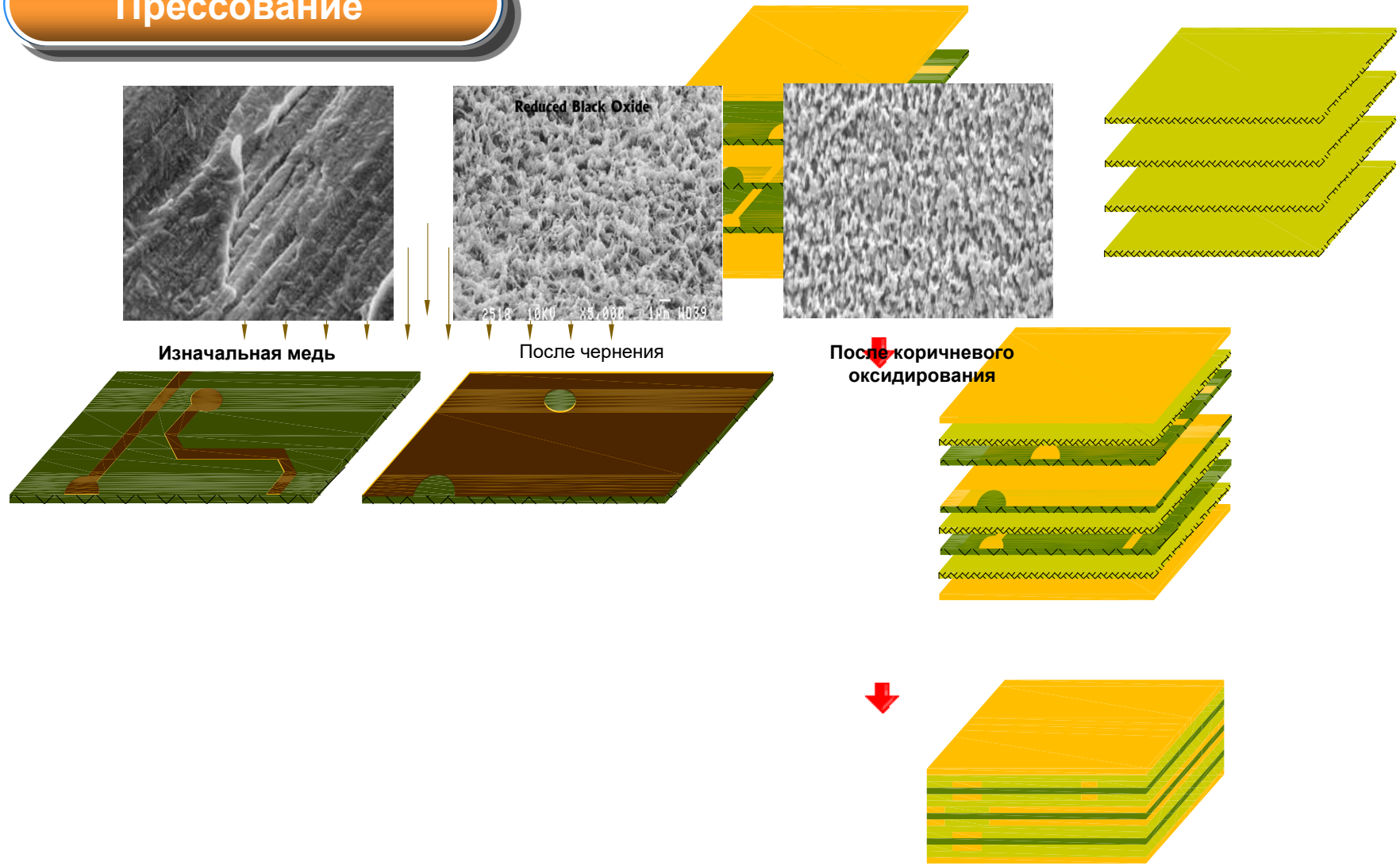
Рисунок в САПР

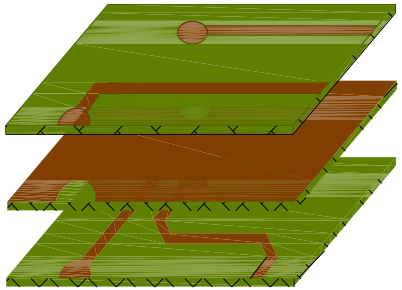


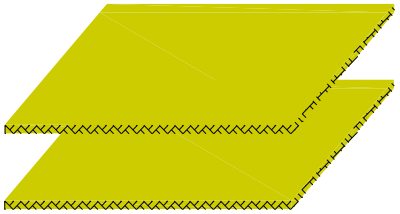
Сканирование…

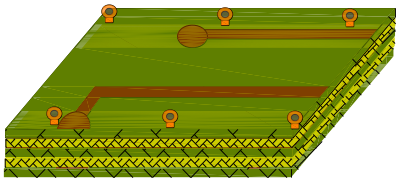
Повышение шероховатости медных проводников и складывание стека из ядер и препрегов.

Прессование

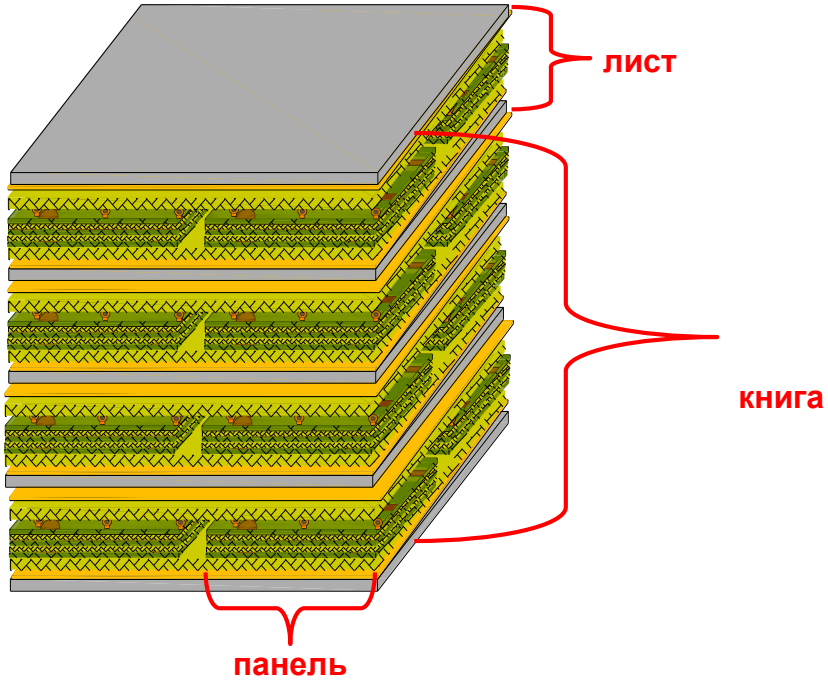






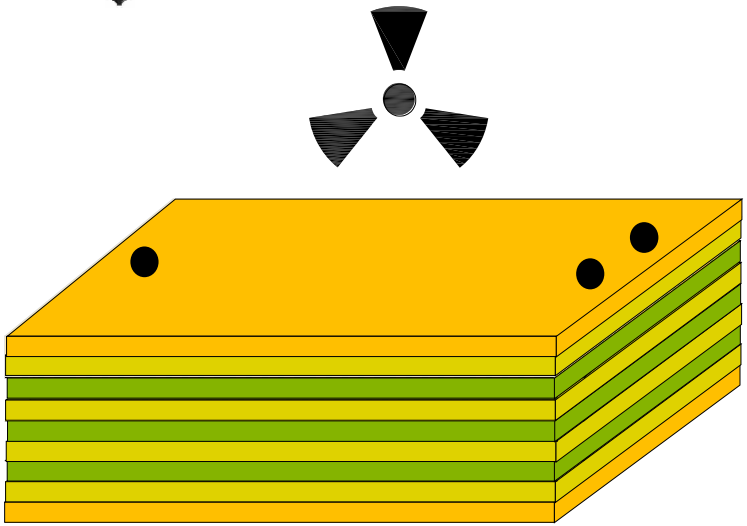


Прессование пакетов



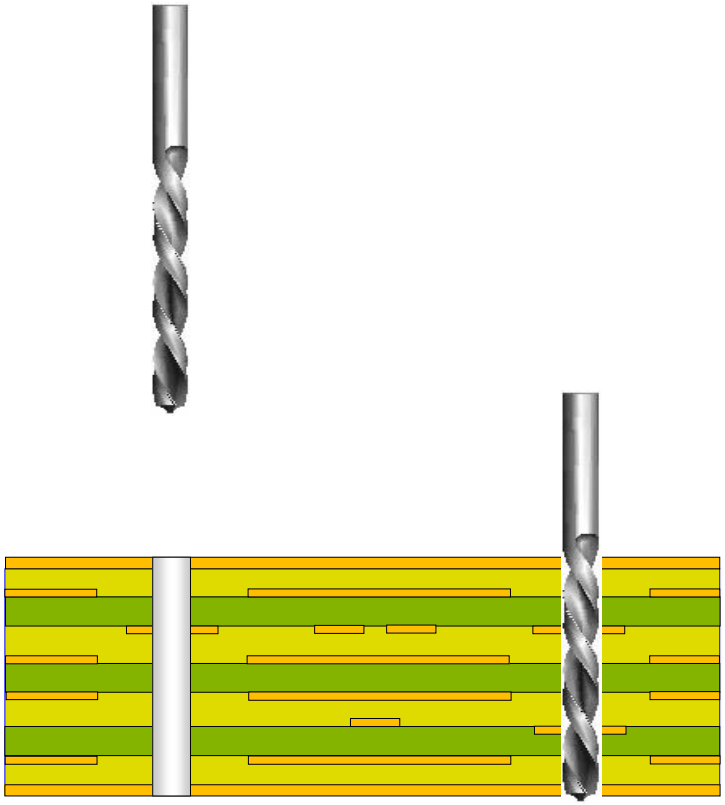
Сверление

С помощью рентгена, сверление базовых отверстий во внутренних слоях.



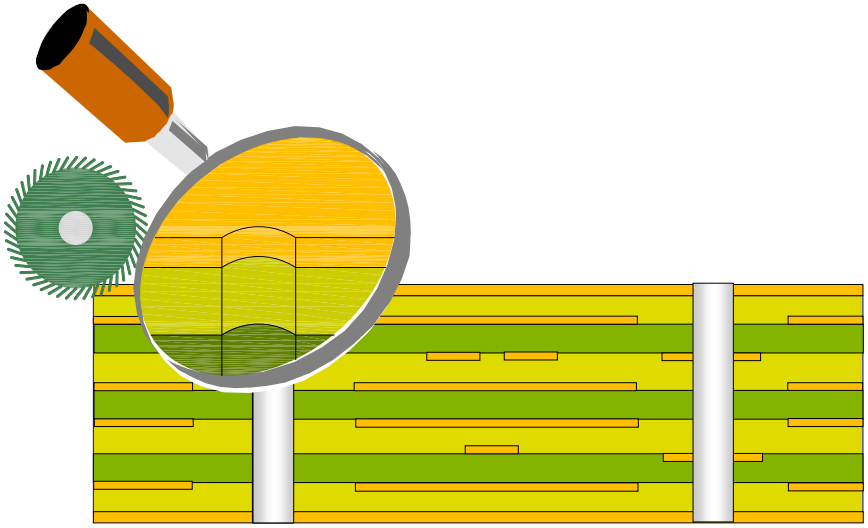
Сверла

Сверление типичного отверстия.



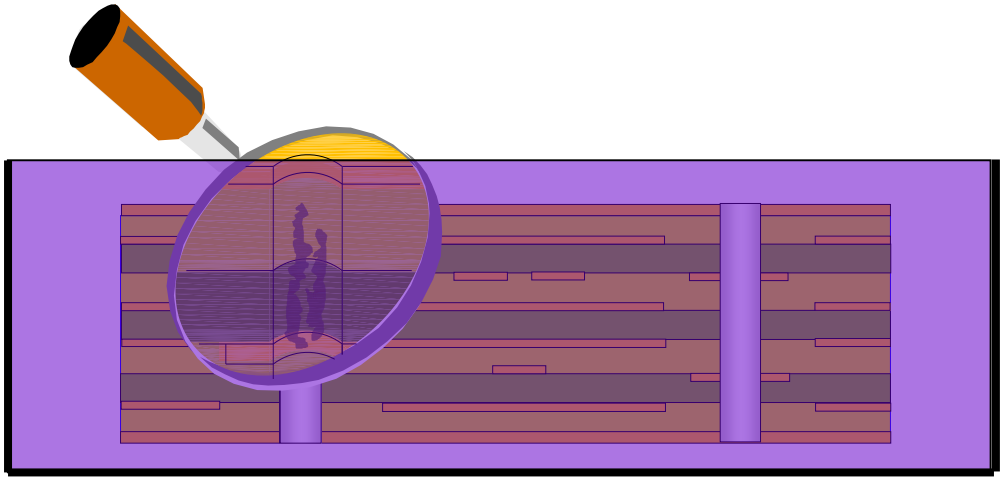
Очистка

Устранение заусенцев, появившихся после сверления.



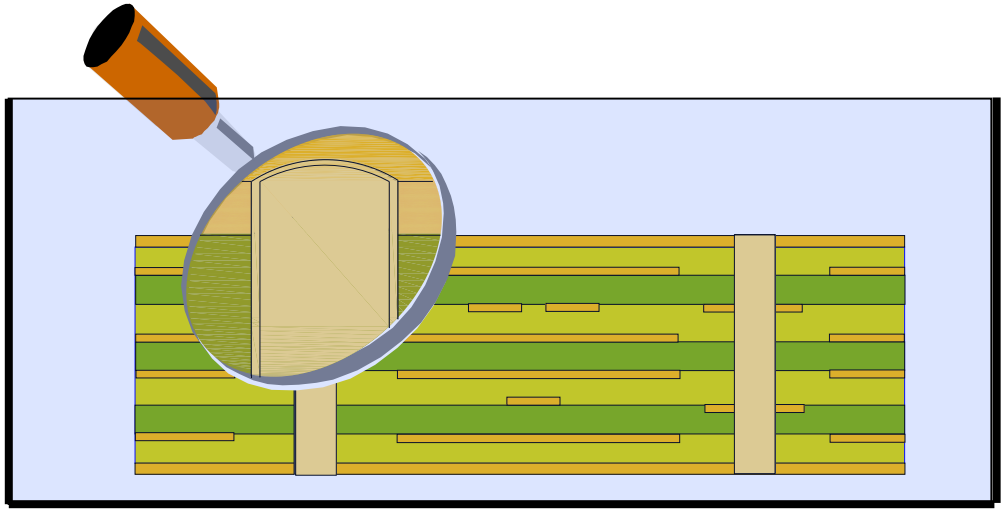
Хим.очистка

Удаление грязи и наплывов, с использованием химии или плазмы。



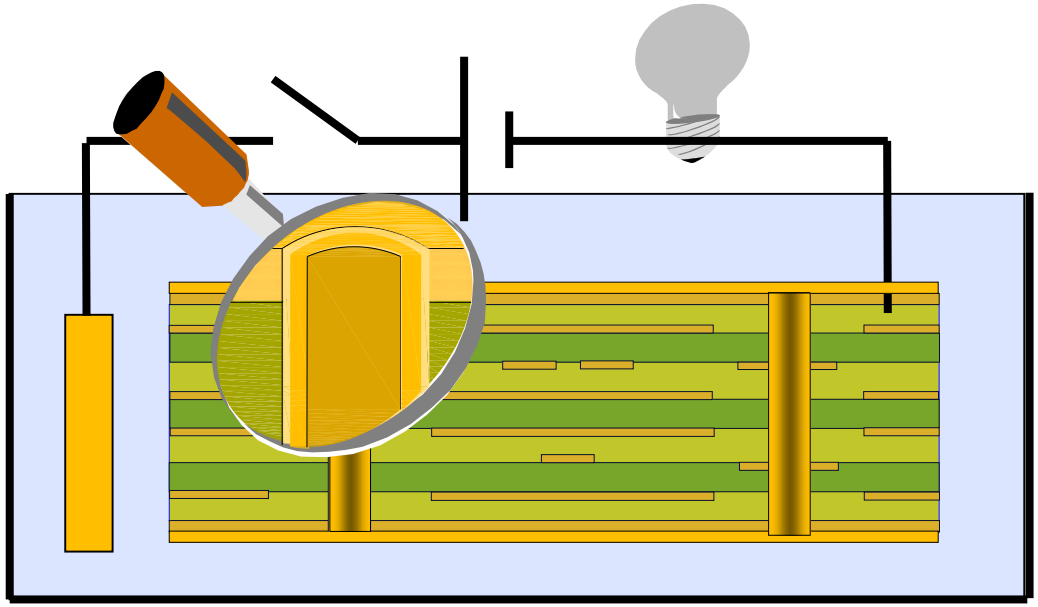
Химическая металлизация

Тонкая химическая металлизация отверстий.



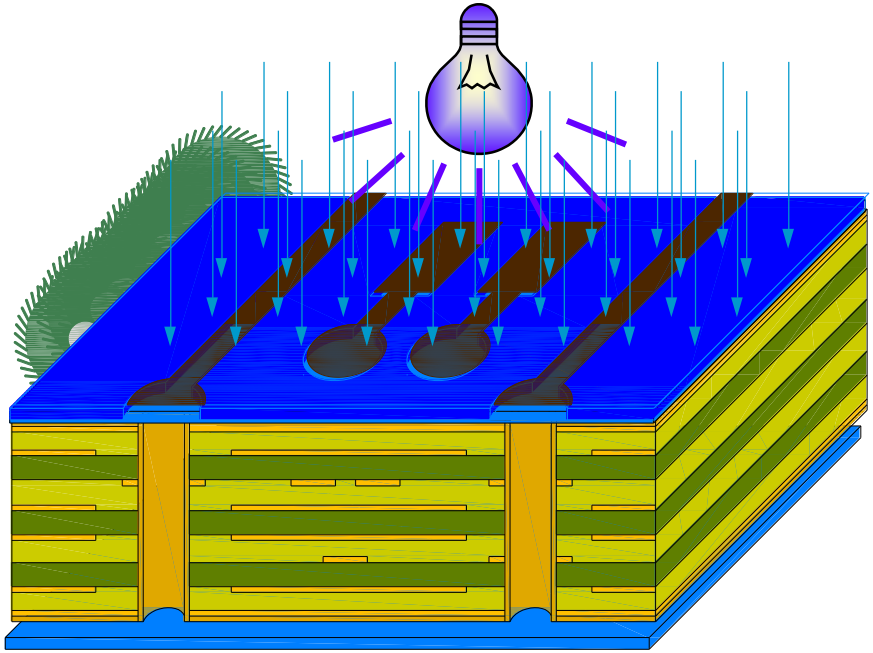
Гальваническая металлизация

Первичная гальваническая металлизация отверстий



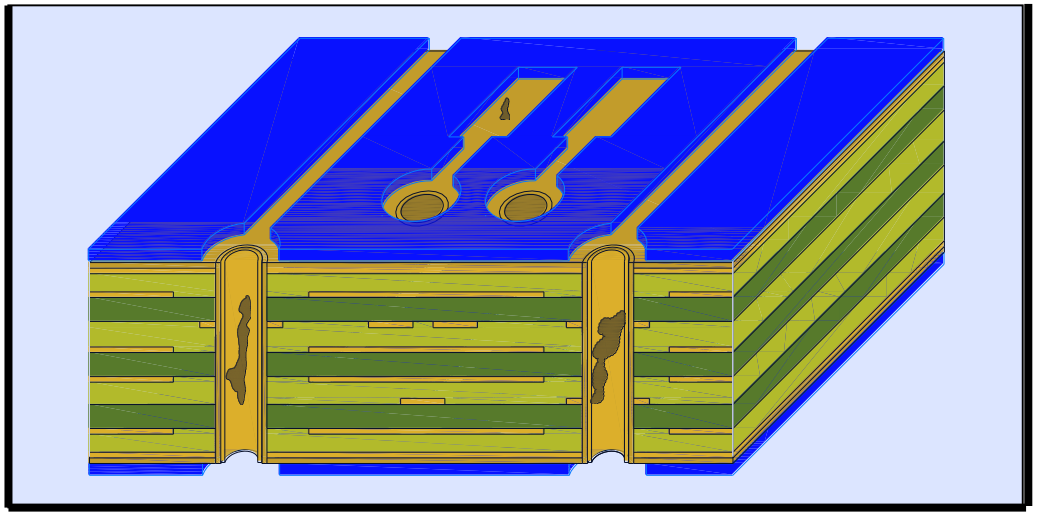
Фотоэкспонирование внеш.слоев

Нанесение и экспонирование фоторезиста там, где требуется медная металлизация.



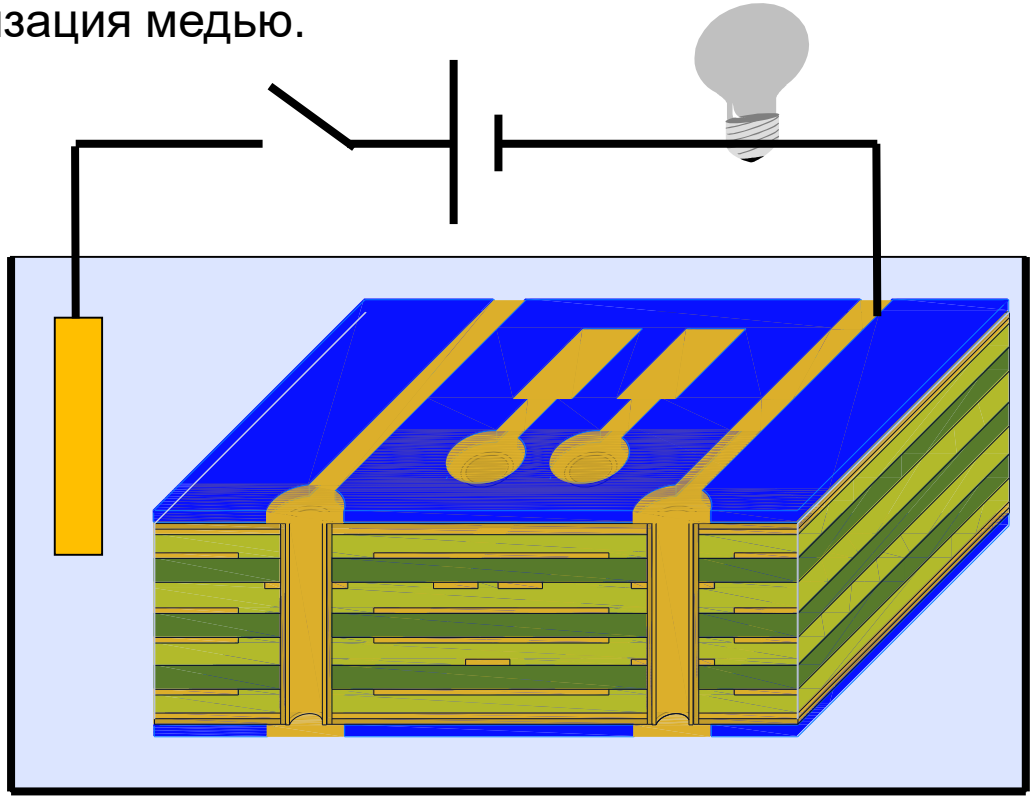
Металлизация топологии

Очистка панели



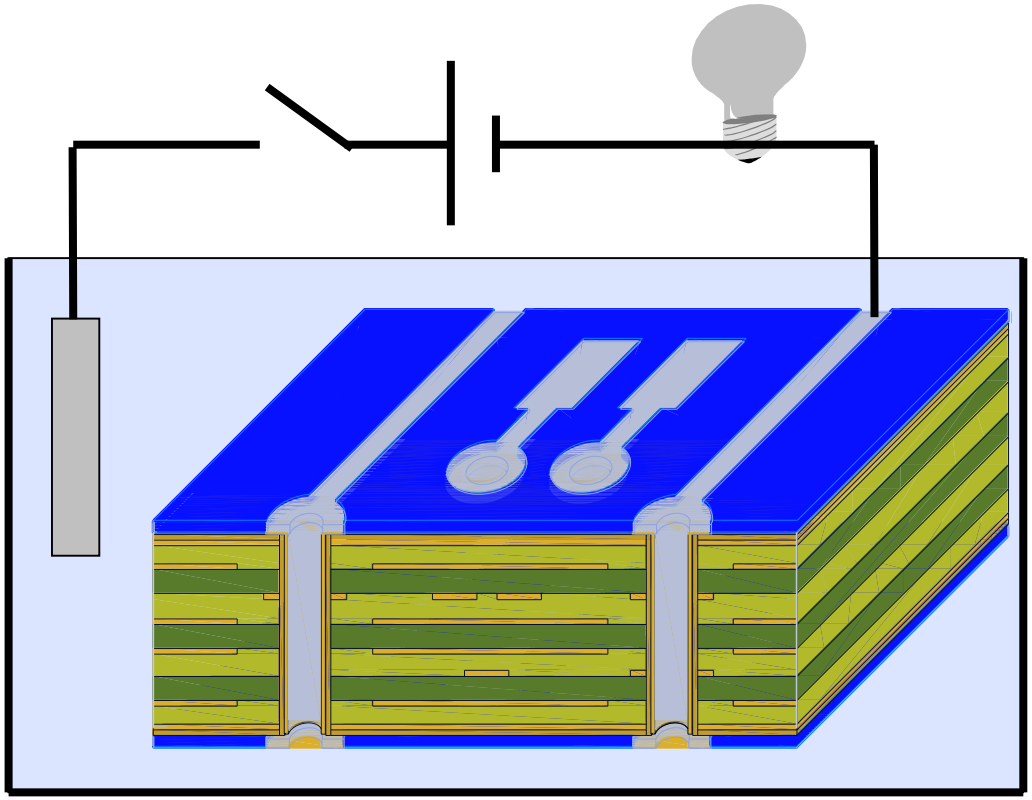
Металлизация топологии

Металлизация медью.



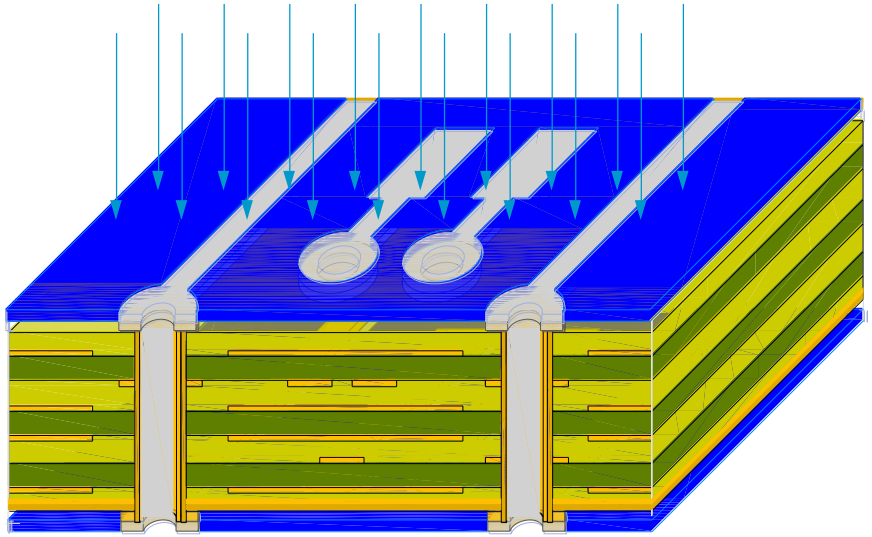
Металлизация топологии

После металлизации медью – покрытие оловом для защиты.



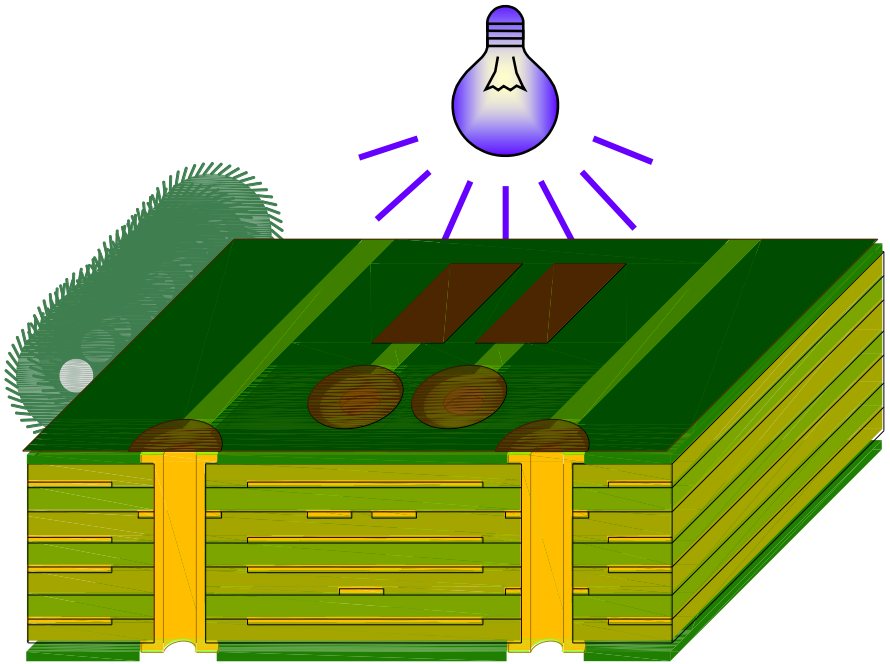
Травление

Удаление остатков фоторезиста и лишней меди (травление), получение рисунка проводников, удаление олова.



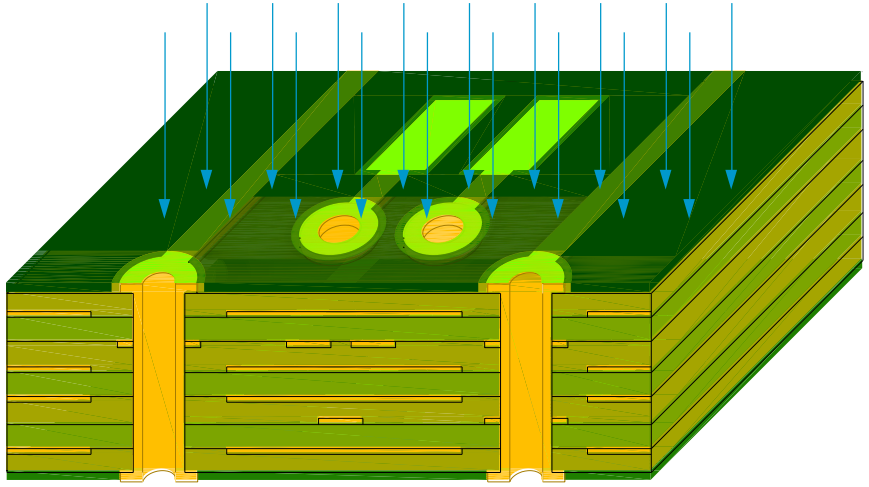
Маска

Очистка, нанесение паяльной маски, фотоэкспонирование.



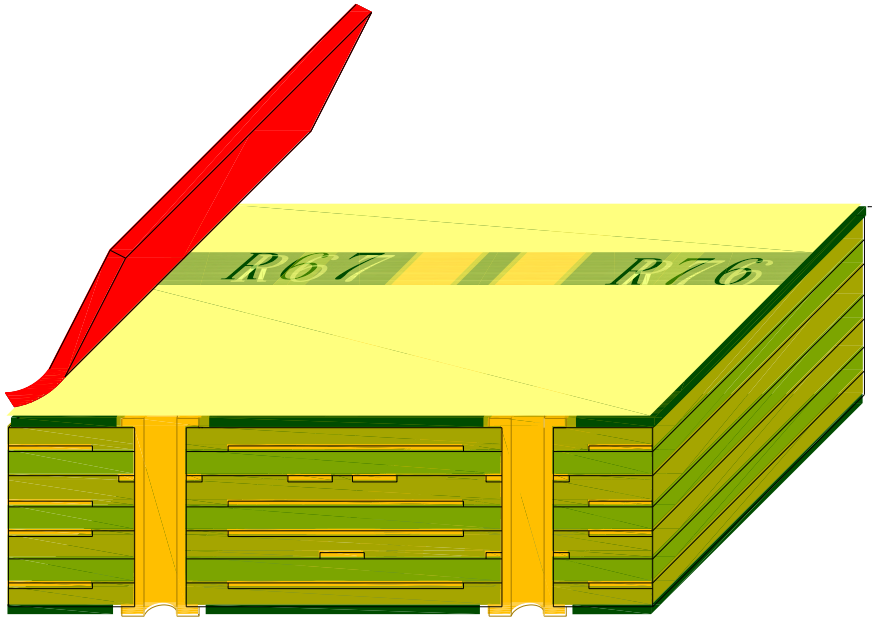
Маска

Удаление непроявленной паяльной маски с площадок.



Маркировка

Нанесение маркировки методом шелкографии.



Очистка поверхности

E-test

Контур

Контроль качества

Дополнительная информация:
ООО «ПСБ технологии»
Москва

www.pcbtech.ru

Тел. +7 (800) 333-97-22